

证券代码：301389

证券简称：隆扬电子

隆扬电子（昆山）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-008

活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线上会议</u>
参与单位名称	中金证券、嘉实基金、华安基金、长城基金、诺安基金、中银基金、新华资产、聚鸣投资、Hao capital、Blackrock、Trinvest、海富通基金、国寿养老、长江养老、盘京投资、财通资管、宏道投资（以上排名不分先后）
时间	2025年7月4日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长 傅青炫 董事会秘书 金卫勤 证券事务代表 施翌
主要内容介绍	<p>公司董事长向与会人员介绍了公司概况、发展布局、公司重大事项，董事长同与会人员进行了问答交流，本次交流主要内容如下：</p> <p>Q1、HVLP5 铜箔的竞争格局是什么样的？ 答：HVLP5 等级的铜箔公司目前正在和客户进行产品验证和测试阶段，其他的参与玩家主要为日本企业。</p> <p>Q2、公司的工艺路线是什么？ 答：公司的工艺路线主要为真空磁控溅射+精细电镀+化学及物理的后端处理。</p>

	<p>Q3、公司铜箔对整个铜箔基板的影响是什么样的？</p> <p>答：理论上，基于集肤效应的原理，铜箔的表面粗糙度越低，相应的对电流损耗就越少。但整个铜箔基板除铜箔之外仍需要结合玻纤布、树脂等其他材料，进行综合性能的测试。</p> <p>Q4、公司是否有供应 hv1p1-3 的铜箔？公司竞争的格局如何？</p> <p>答：公司没有参与 hv1p3 等级以下铜箔的产品竞争，公司的工艺路线在制作 hv1p3 等级以下的铜箔时不具备成本优势。但是在做超薄、超平坦铜箔时，公司的工艺路线有一定优势；所以公司选择从 hv1p5 等级铜箔产品开始参与市场开发。</p> <p>Q5、关于收购威斯双联的目的？</p> <p>答：公司收购威斯双联 51%股权，主要是威斯双联与公司隶属同一行业，具有显著的协同效应。公司通过本次收购，可优化供应链管理，未来降低公司生产成本。依托威斯双联在高分子材料及吸波材料研发领域具备深厚的技术积累和创新能力，可实现双方技术上优势互补、客户资源共享，同时保持业务端的独立运营体系，以并行发展模式释放协同价值，推动业绩提升。</p> <p>Q6、关于收购德佑新材可为公司带来哪些效益？</p> <p>答：公司收购德佑新材 70%股权，是基于公司的未来经营发展布局需要；收购后可以增厚公司业绩，整合德佑新材在功能涂层材料、精密涂布工艺上的技术优势，补足公司在减震、保护、固定等方面的自研材料体系，进一步丰富公司的产品类别，拓宽现有客户结构，并拓展公司新材料在 3C 消费电子、汽车电子等领域的发展布局；目前此项目还未召开股东大会，公司将依规定审批进度，适时进行信息披露。</p>
附件清单（如有）	无
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的	公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄

说明	露等情况。
日期	2025年7月4日